

INVESTORS GUIDE



Year Ended March 31, 2017 (FY2016)
2017年3月期（2016年度）

Financial Highlights / 連結財務ハイライト	1
Market Data / 市場データ	2
Operating Segments / 事業セグメント	3
Financial Results, Geographic Sales, Number of Employees / 連結経営成績、地域別売上高、従業員数	5
Operating Results by Operating Segment / 事業セグメントの状況	6
Profitability, R&D Expenses, Capital Expenditures, Depreciation and Amortization / 収益性、研究開発費、設備投資額、減価償却費	7
Financial Position, Cash Flow Condition / 連結財政状態、連結キャッシュ・フローの状況	8
Share Information / 株式情報	9

*Financial data are presented in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) from the fiscal year ended March 31, 2015 and the data before then are presented based on US GAAP.

※2014年3月期までの財務データは米国会計基準（US GAAP）、2015年3月期以降の財務データは国際会計基準（IFRS）に基づき作成しています。

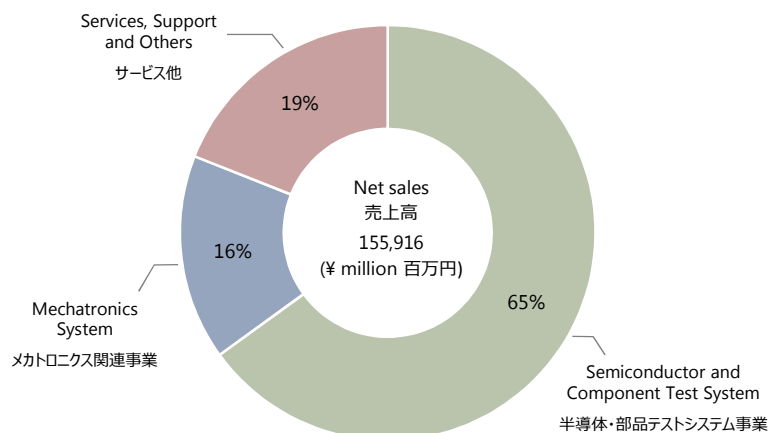
2017
3/2017
03/2017
03

(¥ million)	(百万円)	03/15	03/16	03/17
Net sales	売上高	163,803	162,111	155,916
Operating income	営業利益	16,858	12,597	13,905
Operating income margin	営業利益率	10.3%	7.8%	8.9%
Net income attributable to owners of the parent	親会社の所有者に帰属する当期利益	16,753	6,694	14,201
Net income margin	売上高当期利益率	10.2%	4.1%	9.1%
Basic earnings per share (¥)	基本的1株当たり当期利益 (円)	96.15	38.35	81.07
Shareholders' equity *	株主資本 (※注)	101,810	93,619	109,517
Free cash flows *	フリー・キャッシュ・フロー (※注)	23,171	5,333	12,312
ROE *	株主資本利益率 (ROE) (※注)	18.5%	6.9%	14.0%
Total assets	資産合計	233,237	210,451	231,603

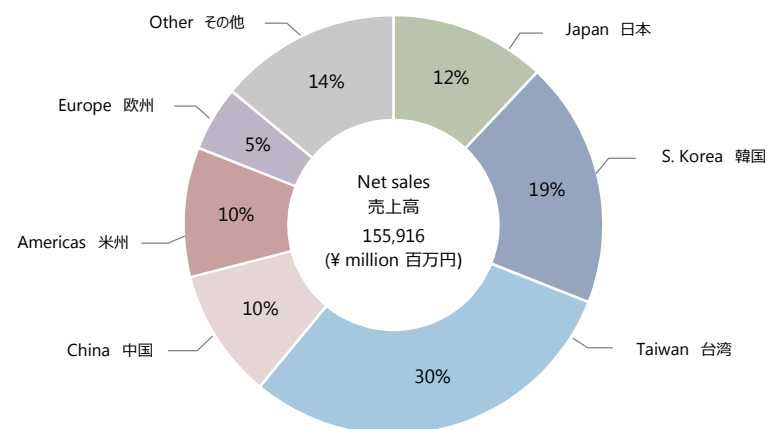
*Note: Shareholders' equity= Equity attributable to owners of the parent (IFRS)
 Free cash flows= Cash flows from operating activities + Cash flows from investing activities
 ROE= Net income attributable to owners of the parent / Average shareholders' equity

※注：株主資本＝親会社の所有者に帰属する持分（国際会計基準）
 フリー・キャッシュ・フロー＝営業キャッシュ・フロー＋投資キャッシュ・フロー
 株主資本利益率＝親会社の所有者に帰属する当期利益÷株主資本（期中平均）

Net Sales by Operating Segment
事業セグメント別売上高

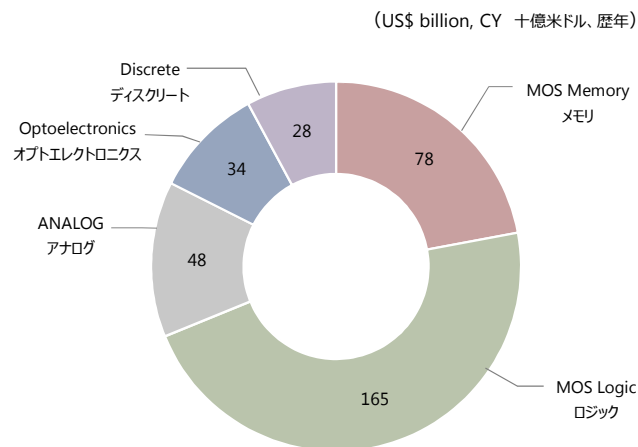


Geographic Sales
地域別売上高



Semiconductor Market by Category in 2016

2016年半導体品種別売上高



Source: VLSI Research, 2017

Worldwide IC Manufacturing Equipment Sales Top 10

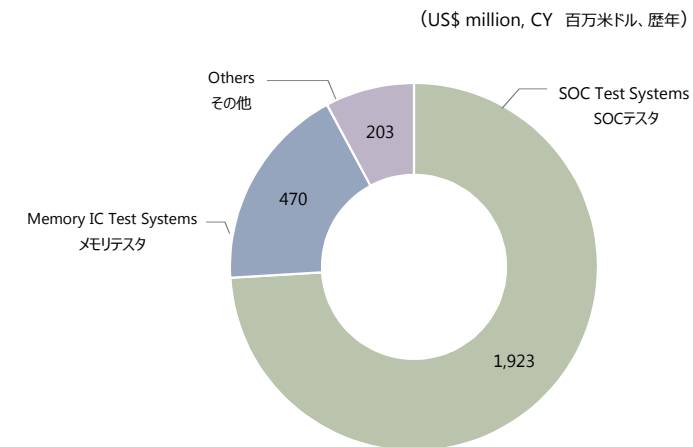
世界半導体製造装置メーカー売上上位10社

COMPANY	2016
Applied Materials	9,876
ASML	7,337
Lam Research	6,375
Tokyo Electron 東京エレクトロン	6,064
KLA-Tencor	3,200
SCREEN Holdings SCREENホールディングス	1,787
Advantest アドバンテスト	1,415
Teradyne	1,368
Hitachi High-Technologies 日立ハイテクノロジーズ	1,129
ASM Pacific	930

Source: VLSI Research, 2017

Breakdown of IC Automated Test Equipment Market in 2016

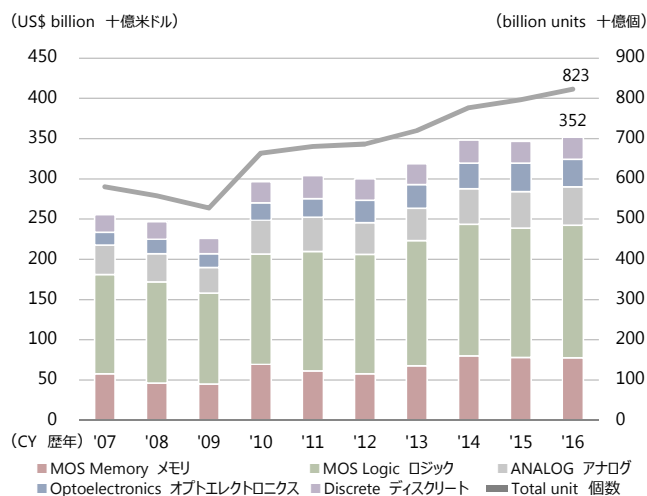
2016年の半導体試験装置市場



Source: VLSI Research, 2017

Trend of Worldwide Semiconductor Market

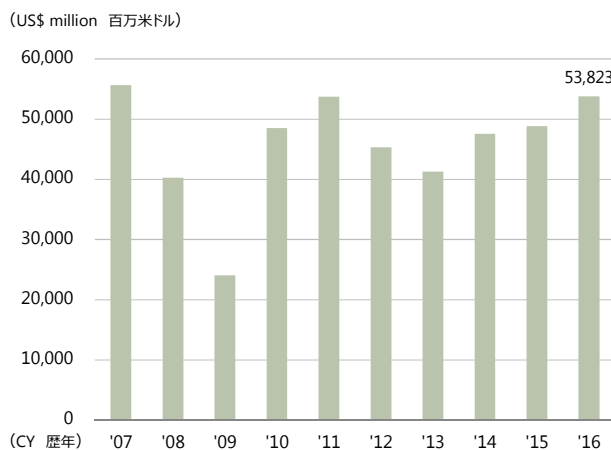
半導体市場の推移



Source: VLSI Research, 2017

Trend of IC and Related Equipment Market

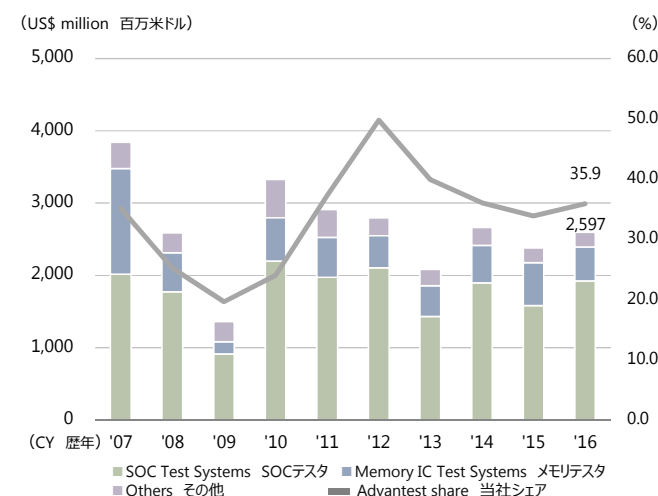
半導体製造装置市場の推移



Source: VLSI Research, 2017

Trend of IC Automated Test Equipment Market

半導体試験装置市場の推移



Source: VLSI Research, 2017

Semiconductor and Component Test System 半導体・部品テストシステム事業

Semiconductor test systems, known as Automatic Test Equipment (ATE), are essential to quality assurance. Advantest is a pioneer in this field and a world leader in test technology. Our diverse, high-productivity solutions provide unmatched support for suppliers of various devices, ranging from logic ICs to the memory chips used in computers, servers, game consoles, smartphones and vehicles.

半導体試験装置 (ATE) は、半導体デバイスが正しく動作するか、良否判定を行うための装置です。業界随一の技術力により、世界トップクラスの市場シェアを占める当社の主力事業です。スマートフォン、パソコン、ゲーム機、自動車などに使われるロジックICやメモリICなどのさまざまな半導体の試験ニーズを、多彩なソリューションと高い生産性で支えます。

Non-Memory Test System 非メモリ半導体用テストシステム



V93000
SoC Test System
SoCテスト・システム



T2000
SoC Test System
SoCテスト・システム



T6391
Display Driver Test System
ディスプレイ・ドライバ・テスト・システム

Memory Test System メモリ半導体用テストシステム



T5503HS
for High-Speed DRAM Package Test
高速DRAMパッケージ試験用



T5833
for DRAM and NAND Flash Memory
DRAM・NANDフラッシュ向け



T5851
for High-Speed NAND Protocol Test
高速NANDプロトコル試験用

Mechatronics System メカトロニクス関連事業

Test Handlers テスト・ハンドラ

Test handlers transfer packaged semiconductors in large batches to a test system, then grade them, identifying faulty devices. Featuring high-throughput thermal control and highly accurate placement technology, Advantest's test handlers support the manufacturing of leading-edge semiconductor devices.

テスト・ハンドラは、パッケージされた半導体を多数個同時に半導体試験装置に搬送し、判定結果に従って分別する装置です。当社の高速・高精度な温度コントロール技術と位置決め技術が、最先端半導体デバイスの量産を支えています。



M4871
SoC Test Handler
SoCテスト・ハンドラ



M6245
Memory Test Handler
メモリ・テスト・ハンドラ

Device Interfaces デバイス・インタフェース

DI products are electrical and mechanical units that connect semiconductor devices to test systems. They include probe cards, load boards, HIFIX, and change kits. Advantest's high-quality data transfer technology, and our worldwide network of design and production facilities, enable our DI products to contribute significantly to reducing customers' time-to-market.

デバイス・インタフェースは、半導体デバイスを半導体試験装置に接続する際に必要となる、プローブ・カード、HIFIX、チェンジ・キットなどの周辺ユニットの総称です。世界を網羅する設計・生産ネットワークと電気信号を高品質に伝送する技術で、お客様の設計・製造リードタイム短縮に貢献します。



Change Kit
チェンジ・キット



HIFIX



Probe Card
プローブ・カード

Mechatronics System メカトロニクス関連事業

Nanotechnology ナノテクノロジー

Advantest offers two families of nanotechnology products that contribute to cutting-edge semiconductor manufacturing and process development, utilizing the electron beam (EB) control technologies we have amassed through our R&D activities. Our EB lithography systems write 1x nanometer node circuit patterns onto semiconductor wafers and other substrates, while our metrology/review systems enable real-time measurement and defect review of pattern width, height, and side wall angles.

アドバンテストが培ってきた電子ビーム（EB）制御技術に応用した、最先端の半導体製造・プロセス開発に貢献する製品です。半導体ウエハなどに微細な回路パターンを描画するEB露光装置と、フォトマスクや半導体ウエハに描画された回路パターンの幅、高さ、側壁角度をリアルタイム3次元計測／欠陥レビューできる測長SEM（走査型電子顕微鏡）などのEB計測装置を提供しています。



F7000
EB Lithography System
電子ビーム露光装置



E3640
MASK MVM-SEM®
フォトマスク向け測長SEM

Services, Support and Others サービス他

Advantest provides diverse customer-support solutions, including semiconductor test equipment installation and maintenance, and applications to improve the productivity of installed test systems.

Additionally, we continue to develop groundbreaking products such as SSD protocol testers, terahertz spectroscopic / imaging systems, on-demand testing systems, and mobile handset system test solutions, targeting diverse new markets. Earnings from these new businesses are also included in this segment.

半導体試験装置の設置・メンテナンスサービスや、設置済みの試験装置の生産性を改善するアプリケーションの提供など、お客様をサポートするさまざまなソリューションをお届けしています。

また、SSDプロトコル・テスト、テラヘルツ分光・イメージング解析システム、オンデマンド型テスト・ソリューション、モバイル機器のシステム・レベル・テストソリューションなど、半導体デバイス以外の市場を対象とする新たな事業の育成にも挑戦しています。



MPT3000
SSD Test System
SSDプロトコル・テスト



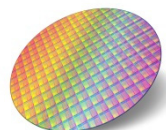
TAS7500
Terahertz Spectroscopic
Imaging System
テラヘルツ分光・イメージング解析装置



CX1000P
CloudTesting™ Station
クラウドテスト・ステーション

Advantest's Role in the Semiconductor Manufacturing Process 半導体製造プロセスと当社の関わり

Front End 前工程



Form circuit patterns on wafers
ウエハ上に回路パターンを形成して、ICチップを作る

Photomask Making
フォトマスク作成

Wafer Process
ウエハ加工

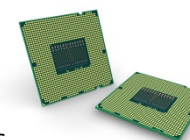
Wafer Test
ウエハ試験

Metrology/Review System
EB計測装置

EB Lithography System
EB露光装置

Test System
テスト・システム
Device Interface
デバイス・インタフェース

Back End 後工程



Dice wafers and package IC chips
ウエハを切断し、1個1個のICチップをパッケージ化する

Assembly
組み立て

Final Test
最終試験

Test System
テスト・システム
Test Handler
テスト・ハンドラ
Device Interface
デバイス・インタフェース

An example of a back-end test cell:
tester + handler + Device Interface
後工程でのテスト使用イメージ

Test Handler
テスト・ハンドラ

Device Interface
デバイス・インタフェース

Test System (Test Head)
テスト・システム (テスト・ヘッド)

Test System (Mainframe)
テスト・システム (メインフレーム)



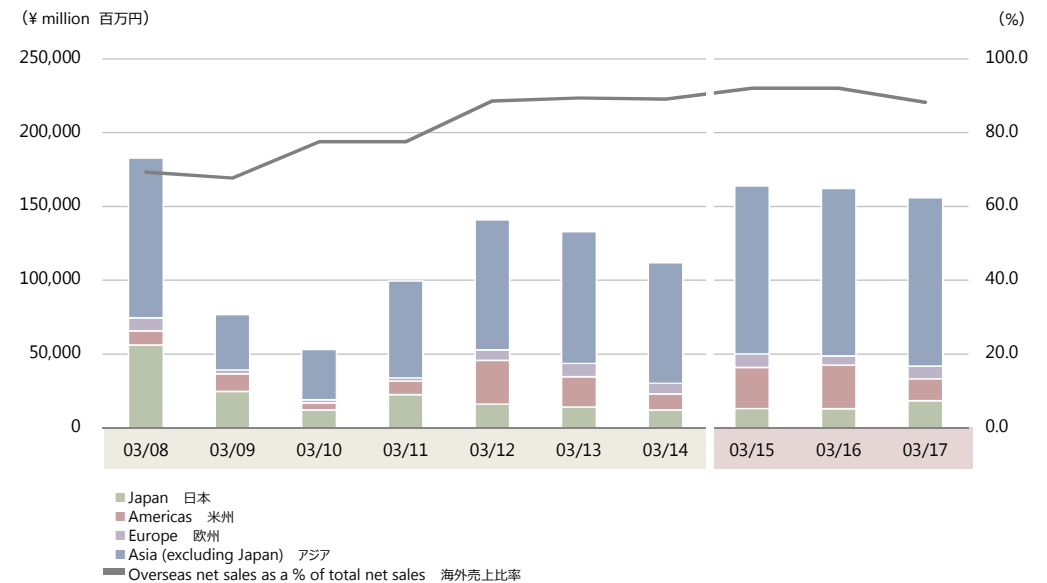
Financial Results

連結経営成績



Geographic Sales

地域別売上高

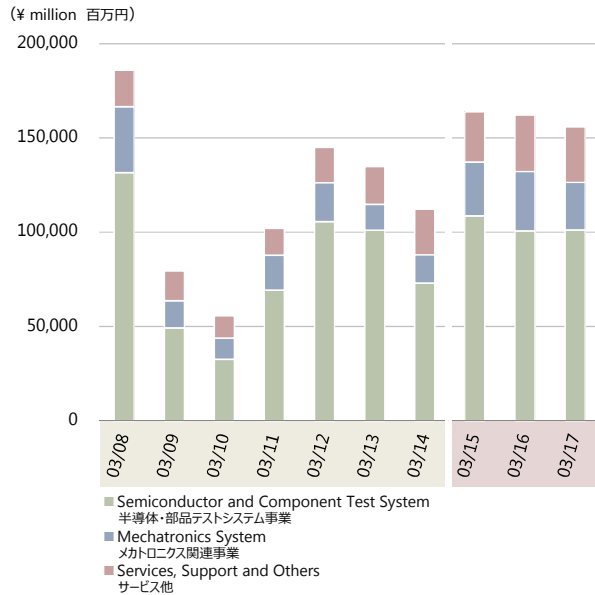


(¥ million)	(百万円)	03/08	03/09	03/10	03/11	03/12	03/13	03/14	03/15	03/16	03/17
Financial results	連結経営成績	US GAAP / 米国会計基準							IFRS / 国際会計基準		
Net sales	売上高	182,767	76,652	53,225	99,634	141,048	132,903	111,878	163,803	162,111	155,916
Gross profit	売上総利益	93,930	19,815	25,928	48,470	68,748	68,920	49,333	91,755	91,475	89,740
Operating income (loss)	営業利益 (損失)	22,716	(49,457)	(11,639)	6,111	837	80	(36,369)	16,858	12,597	13,905
Income (loss) before income taxes	税引前利益 (損失)	23,533	(52,761)	(9,926)	5,551	(3,442)	(1,293)	(35,501)	20,767	11,767	15,022
Net income (loss) attributable to owners of the parent	親会社の所有者に帰属する当期利益 (損失)	16,550	(74,902)	(11,454)	3,163	(2,195)	(3,821)	(35,540)	16,753	6,694	14,201
Geographic sales*	地域別売上高 (※注)										
Japan	日本	56,032	24,734	11,976	22,398	16,095	14,045	12,221	13,112	12,979	18,443
Americas	米州	9,616	11,759	4,930	9,278	29,742	20,583	10,720	27,783	29,551	14,840
Europe	欧州	8,859	2,844	2,137	2,252	7,015	9,061	7,276	9,077	6,181	8,510
Asia (excluding Japan)	アジア	108,260	37,315	34,182	65,706	88,196	89,214	81,661	113,831	113,400	114,123
Overseas net sales as a % of total net sales	海外売上比率	69.3%	67.7%	77.5%	77.5%	88.6%	89.4%	89.1%	92.0%	92.0%	88.2%
Number of employees	従業員数										
Number of employees	従業員数 (人)	3,666	3,187	3,151	3,163	4,464	4,575	4,625	4,564	4,494	4,414
Average temporary employees	(外、平均臨時雇用者数)	909	565	217	223	279	330	278	197	162	148

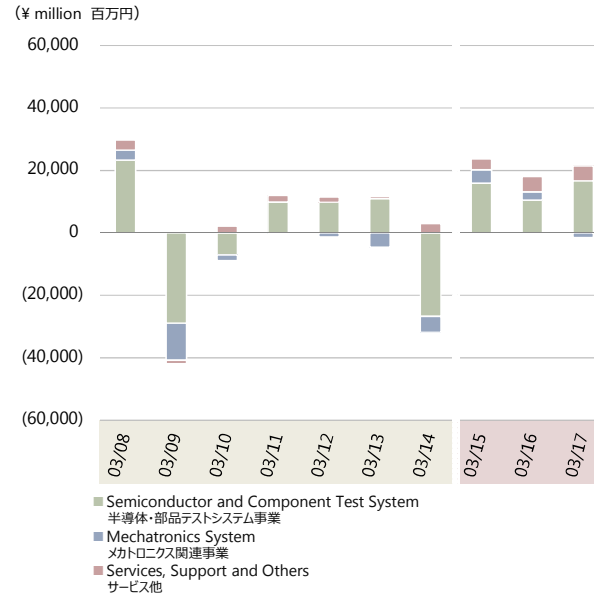
*Note: Geographic sales are based on the location to which the products shipped.

※注：地域別売上高は、出荷先の所在地に基づいています。

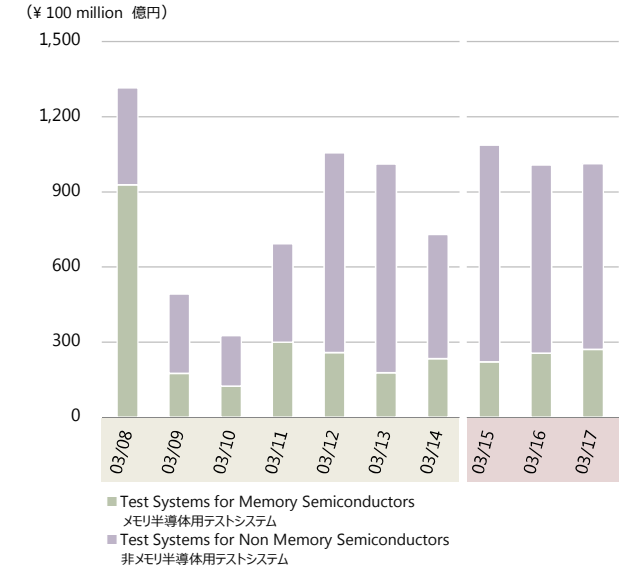
Net sales by Operating Segment
事業セグメント別売上高



Operating Income (Loss) by Operating Segment
事業セグメント別営業利益 (損失)

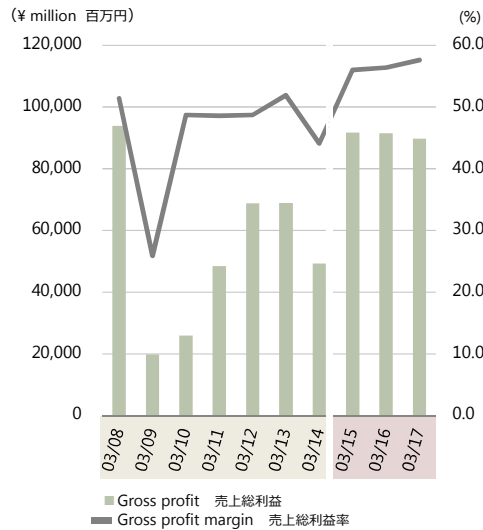


Net Sales Breakdown of Semiconductor and Component Test System Segment
半導体・部品テストシステム事業売上高内訳

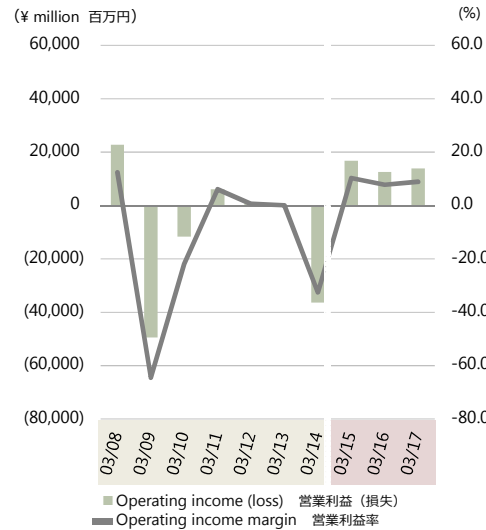


(¥ million) (百万円)		03/08	03/09	03/10	03/11	03/12	03/13	03/14	03/15	03/16	03/17	
Net sales by operating segment	事業セグメント別売上高	US GAAP / 米国会計基準								IFRS / 国際会計基準		
Semiconductor and Component Test System	半導体・部品テストシステム事業	131,608	49,216	32,572	69,333	105,608	101,119	73,017	108,686	100,762	101,266	
Mechatronics System	メカトロニクス関連事業	34,944	14,388	11,237	18,515	20,616	13,653	14,984	28,461	31,482	25,192	
Services, Support and Others	サービス他	19,344	15,815	11,838	14,166	18,807	20,077	24,151	26,746	29,923	29,496	
Elimination and Corporate	消去または全社	(3,129)	(2,767)	(2,422)	(2,380)	(3,983)	(1,946)	(274)	(90)	(56)	(38)	
Operating income (loss) by operating segment	事業セグメント別営業利益 (損失)	US GAAP / 米国会計基準								IFRS / 国際会計基準		
Semiconductor and Component Test System	半導体・部品テストシステム事業	23,263	(28,914)	(7,042)	9,857	9,845	10,956	(26,724)	15,955	10,514	16,652	
Mechatronics System	メカトロニクス関連事業	3,266	(11,865)	(1,897)	(251)	(1,324)	(4,614)	(5,063)	4,288	2,599	(1,529)	
Services, Support and Others	サービス他	3,177	(1,099)	2,175	2,133	1,614	775	3,012	3,452	4,944	4,817	
Elimination and Corporate	消去または全社	(6,132)	(7,331)	(4,732)	(5,463)	(8,715)	(6,176)	(6,311)	(6,837)	(5,460)	(5,353)	
(¥ 100 million) (億円)		US GAAP / 米国会計基準								IFRS / 国際会計基準		
Net sales breakdown of Semiconductor and Component Test System Segment	半導体・部品テストシステム事業売上高内訳	US GAAP / 米国会計基準								IFRS / 国際会計基準		
Test Systems for Memory Semiconductors	メモリ半導体用テストシステム	929	176	124	300	259	178	234	221	256	272	
Test Systems for Non Memory Semiconductors	非メモリ半導体用テストシステム	387	316	202	393	797	833	496	866	752	741	
Total	合計	1,316	492	326	693	1,056	1,011	730	1,087	1,008	1,013	

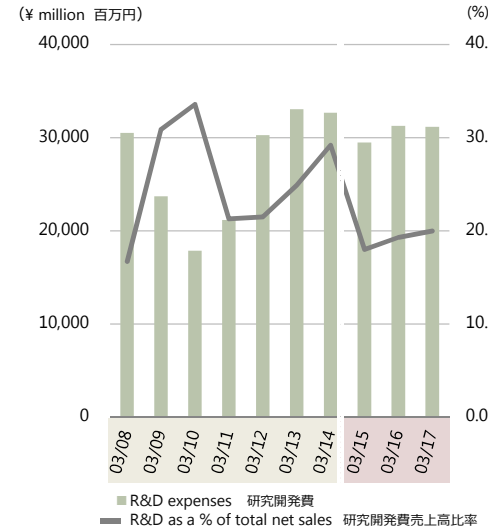
Gross Profit Margin
売上総利益率



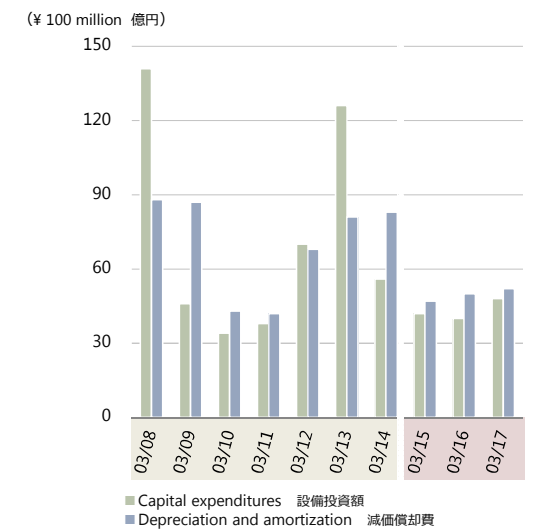
Operating Income Margin
営業利益率



R&D Expenses
研究開発費



Capital Expenditures, Depreciation and Amortization
設備投資額、減価償却費



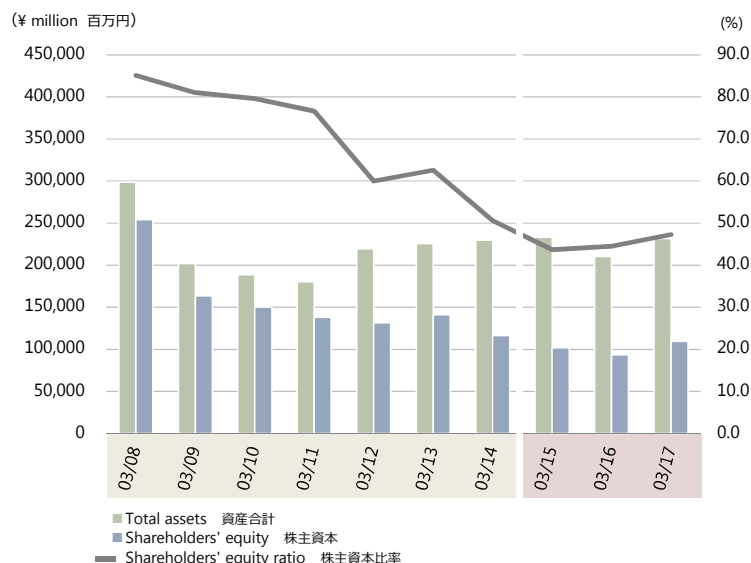
(¥ million)	(百万円)	03/08	03/09	03/10	03/11	03/12	03/13	03/14	03/15	03/16	03/17	
Profitability	収益性	US GAAP / 米国会計基準							IFRS / 国際会計基準			
Net sales	売上高	182,767	76,652	53,225	99,634	141,048	132,903	111,878	163,803	162,111	155,916	
Cost of sales	売上原価	88,837	56,837	27,297	51,164	72,300	63,983	62,545	72,048	70,636	66,176	
Gross profit	売上総利益	93,930	19,815	25,928	48,470	68,748	68,920	49,333	91,755	91,475	89,740	
Gross profit margin	売上総利益率	51.4%	25.9%	48.7%	48.6%	48.7%	51.9%	44.1%	56.0%	56.4%	57.6%	
Selling, general and administrative expenses *	販売費および一般管理費 (※注)	71,214	69,272	37,567	42,359	67,911	68,840	85,702	74,897	78,878	75,835	
Operating income (loss)	営業利益 (損失)	22,716	(49,457)	(11,639)	6,111	837	80	(36,369)	16,858	12,597	13,905	
Operating income margin	営業利益率	12.4%	-64.5%	-21.9%	6.1%	0.6%	0.1%	-32.5%	10.3%	7.8%	8.9%	
Research and development expenses	研究開発費	US GAAP / 米国会計基準							IFRS / 国際会計基準			
Research and development expenses	研究開発費	30,507	23,713	17,896	21,197	30,303	33,062	32,670	29,507	31,298	31,170	
R&D as a % of total net sales	研究開発費売上高比率	16.7%	30.9%	33.6%	21.3%	21.5%	24.9%	29.2%	18.0%	19.3%	20.0%	
(¥ 100 million)	(億円)	US GAAP / 米国会計基準							IFRS / 国際会計基準			
Capital expenditures, Depreciation and amortization	設備投資額、減価償却費	US GAAP / 米国会計基準							IFRS / 国際会計基準			
Capital expenditures	設備投資額	141	46	34	38	70	126	56	42	40	48	
Depreciation and amortization	減価償却費	88	87	43	42	68	81	83	47	50	52	

*Note: Selling, general and administrative expenses from the fiscal year ended March 31, 2015 are composed of selling, general and administrative expenses, other income/expenses. Figures until the fiscal year ended March 31, 2014 consist of research and development expenses, selling, general and administrative expenses, restructuring and impairment charges.

※注：2014年3月期までの販売費および一般管理費は、研究開発費、販売費および一般管理費、構造改革費用、減損費用の合計です。2015年3月期以降は、販売費および一般管理費、その他の収益・費用の合計です。

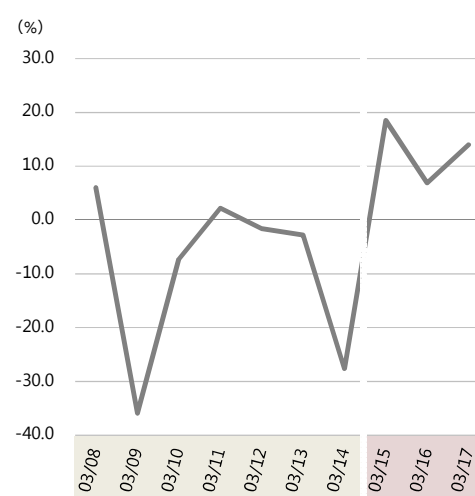
Shareholders' Equity Ratio

株主資本比率



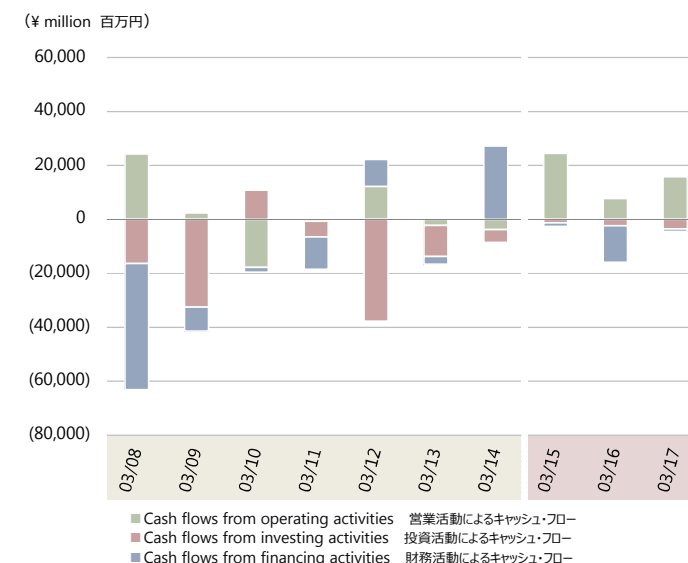
ROE

株主資本利益率



Cash Flows

連結キャッシュ・フロー



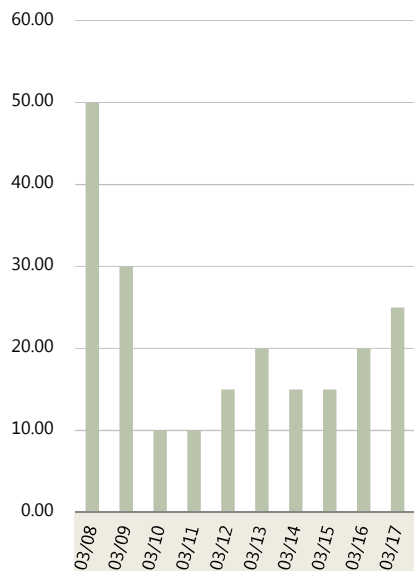
(¥ million)	(百万円)	03/08	03/09	03/10	03/11	03/12	03/13	03/14	03/15	03/16	03/17
Financial position	連結財政状態	US GAAP / 米国会計基準							IFRS / 国際会計基準		
Total assets	資産合計	298,684	202,059	188,663	180,312	219,226	225,515	229,856	233,237	210,451	231,603
Shareholders' equity *	株主資本 (※注)	254,184	163,616	150,242	138,132	131,552	141,241	116,252	101,810	93,619	109,517
Shareholders' equity ratio *	株主資本比率 (※注)	85.1%	81.0%	79.6%	76.6%	60.0%	62.6%	50.6%	43.7%	44.5%	47.3%
ROE *	株主資本利益率 (ROE) (※注)	6.0%	-35.9%	-7.3%	2.2%	-1.6%	-2.8%	-27.6%	18.5%	6.9%	14.0%
Cash flow condition	連結キャッシュ・フローの状況										
Cash flows from operating activities	営業活動によるキャッシュ・フロー	24,166	2,357	(17,746)	(693)	12,302	(2,215)	(3,776)	24,481	7,728	15,833
Cash flows from investing activities	投資活動によるキャッシュ・フロー	(16,322)	(32,507)	10,824	(5,828)	(37,670)	(11,498)	(4,711)	(1,310)	(2,395)	(3,521)
Cash flows from financing activities	財務活動によるキャッシュ・フロー	(46,770)	(8,930)	(1,803)	(12,028)	9,887	(2,914)	27,202	(1,298)	(13,531)	(1,002)
Free cash flows *	フリー・キャッシュ・フロー (※注)	7,844	(30,150)	(6,922)	(6,521)	(25,368)	(13,713)	(8,487)	23,171	5,333	12,312
Cash and cash equivalents at end of year	現金および現金同等物の期末残高	147,348	105,455	96,439	75,323	58,218	45,668	68,997	97,574	85,430	95,324

*Note: Shareholders' equity= Equity attributable to owners of the parent (IFRS)
 Shareholders' equity ratio= Ratio of equity attributable to owners of the parent (IFRS)
 ROE= Net income attributable to owners of the parent / Average shareholders' equity
 Free cash flows= Cash flows from operating activities + Cash flows from investing activities

※注：株主資本 = 親会社の所有者に帰属する持分 (国際会計基準)
 株主資本比率 = 親会社所有者帰属持分比率 (国際会計基準)
 株主資本利益率 = 親会社の所有者に帰属する当期利益 ÷ 株主資本 (期中平均)
 フリー・キャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー

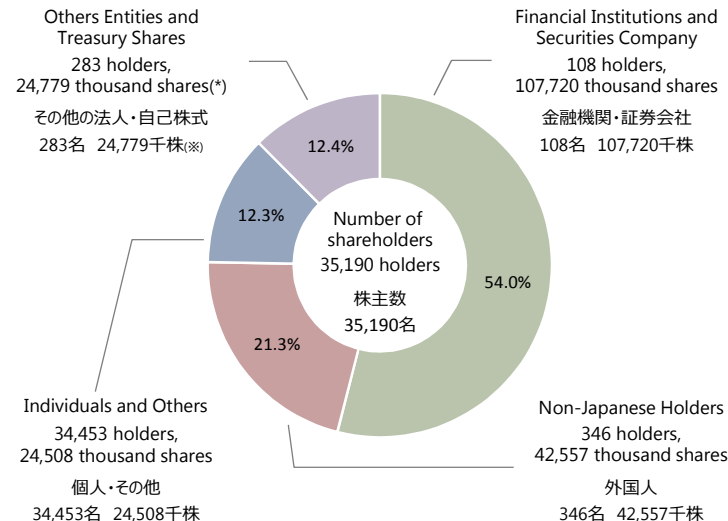
Dividend per Share

1株当たり配当金
(¥ 円)



Breakdown of Shareholders

所有者別株式数分布状況



(*) 22,736,166 shares of treasury shares listed under "Other Entities and Treasury Shares."
(※) 自己株式22,736,166株は「その他の法人・自己株式」に含めて記載しています。

Major Shareholders (Top 10 shareholders)

大株主 (上位10名)

Name of Shareholder 株主名	Number of Shares 持株数	Percentage of Ownership 持株比率
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	39,704	22.45%
Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. (retirement benefit trust (Fujitsu account), re-trust trustees, Trust & Custody Services Bank, Ltd.) みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 富士通口 再信託 受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社	20,142	11.39%
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	18,746	10.60%
Trust & Custody Services Bank, Ltd. (investment trust account) 資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口)	6,087	3.44%
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account 4) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口4)	3,629	2.05%
Barclays Bank PLC a/c re Equities	2,639	1.49%
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account 5) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口5)	2,503	1.41%
Chase Manhattan Bank GTS Clients Account Escrow	2,364	1.33%
JP Morgan Chase Bank 385151	2,107	1.19%
The Bank of New York 133524	1,910	1.08%

(*) Percentage of Ownership is calculated excluding treasury shares (22,736,166 shares).
(※) 持株比率は、自己株式 (22,736,166株) を控除して計算しております。

		03/08	03/09	03/10	03/11	03/12	03/13	03/14	03/15	03/16	03/17
Quarterly share price range	株価の推移 (四半期ベース)										
1Q	High (¥)	5,750	3,100	1,910	2,516	1,663	1,386	1,887	1,303	1,567	1,238
	Low (¥)	5,120	2,235	1,423	1,860	1,387	952	1,246	1,063	1,247	922
2Q	High (¥)	5,450	2,660	2,550	2,020	1,591	1,261	1,710	1,422	1,293	1,556
	Low (¥)	3,410	2,050	1,581	1,571	802	914	1,121	1,126	846	1,021
3Q	High (¥)	3,850	2,240	2,525	1,916	970	1,374	1,343	1,586	1,155	2,003
	Low (¥)	2,855	996	1,864	1,456	718	838	1,061	1,192	841	1,297
4Q	High (¥)	2,975	1,666	2,615	1,924	1,323	1,525	1,315	1,678	1,173	2,214
	Low (¥)	2,100	1,122	2,033	1,179	671	1,156	988	1,301	916	1,874
Number of shares issued	発行済株式数の推移										
Number of shares issued at year-end	発行済株式数 (期末)	199,566,770	199,566,770	199,566,770	199,566,770	199,566,770	199,566,770	199,566,770	199,566,770	199,566,770	199,566,770
Investment indicator	投資指標	US GAAP / 米国会計基準						IFRS / 国際会計基準			
Basic earnings (loss) per share (¥)	基本的1株当たり当期利益 (損失) (円)	90.72	(419.09)	(64.09)	18.03	(12.67)	(22.03)	(204.10)	96.15	38.35	81.07
Diluted earnings (loss) per share (¥)	希薄化後1株当たり当期利益 (損失) (円)	90.57	(419.09)	(64.09)	18.03	(12.67)	(22.03)	(204.10)	87.67	35.38	73.95
Shareholders' equity per share (¥) *	1株当たり株主資本 (円) (※注)	1,422.20	915.47	840.65	797.20	759.22	812.70	667.36	583.28	536.28	619.33
Dividend per share (¥)	1株当たり配当金 (円)	50.00	30.00	10.00	10.00	15.00	20.00	15.00	15.00	20.00	25.00
Dividend payout ratio	配当性向	55.1%	-	-	55.5%	-	-	-	15.6%	52.2%	30.8%

*Note: Shareholders' equity per share= Equity attributable to owners of the parent per share (IFRS)

※注: 1株当たり株主資本 = 1株当たり親会社所有者帰属持分 (国際会計基準)